株式会社エンプラス

２００６年３月期
決算説明会

２００６年　４月２５日

代表取締役社長　杉 本　敏 昭

－ Ｒｅｓｕｍｅ －

- 2006年3月期に実施した主な施策
- 2006年3月期決算概要（連結）
- 2007年3月期通期計画（連結）
- 各事業セグメントのビジネス動向及び計画

2006年3月期に実施した主な施策

2006年3月期に実施した主な施策

総固定費１０億円の削減

■基幹事業の改革

◆エンプラ事業

❖不採算製品からの撤退完了

❖鹿沼工場稼動

◆オプト事業

❖経営資源の集中

➢オプト関連事業部の統合

■本社間接部門のスリム化

3

２００６年3月期に実施した主な施策

Enplas

■グローバル事業戦略再構築

◆東南アジア拠点の戦略的機能強化

- ❖Enplas Hi-tech Singapore 地域統括管理機能強化
  - ➢半導体事業開始
- ❖Enplas (Vietnam) 設立

■子会社２社の清算

- ❖エンプラスオプティクス
- ❖Enplas (Korea)　⇒ソウル連絡事務所へ再編

Enplas

２００６年３月期
決算概要（実績）

損益実績

（単位： 億円）

	2005年3月期 実績		2006年3月期 実績
売上高	394.0	2.0%	401.8
（原価率）	(68.7%)		(70.8%)
営業利益	44.3	△16.8%	36.9
経常利益	45.3	△15.4%	38.3
当期純利益	26.4	△43.1%	15.0
1株当たり当期純利益	124.90円	△43.3%	70.81円
1株当たり配当	24.00円	△2.00円	22.00円

6

セグメント別売上実績

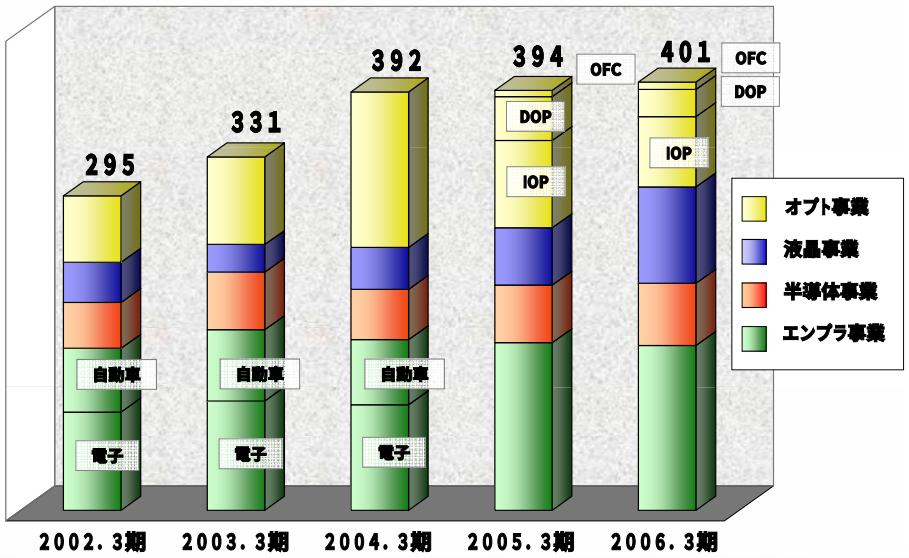
（単位： 億円）

	2005年3月期 実績		2006年3月期 実績
エンプラ事業	157.4	△1.7%	154.7
半導体機器事業	53.9	8.3%	58.3
液晶関連事業	53.8	68.0%	90.4
オプト事業	128.9	△23.7%	98.3
（IOP事業）	(81.9)	△19.5%	(66.0)
（DOP事業）	(41.1)	△38.0%	(25.5)
（OFC事業）	(5.8)	17.1%	(6.8)
計	394.0	2.0%	401.8

7

売上高推移

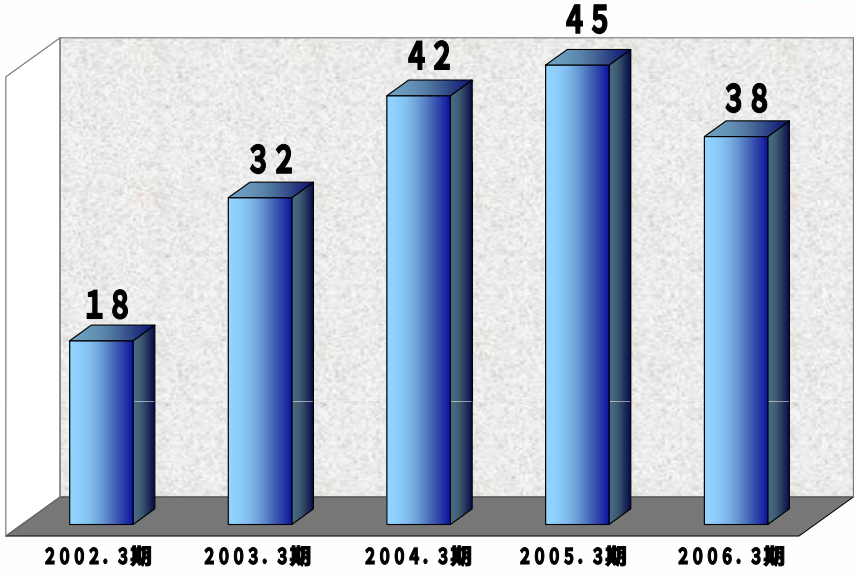
（単位： 億円）



8

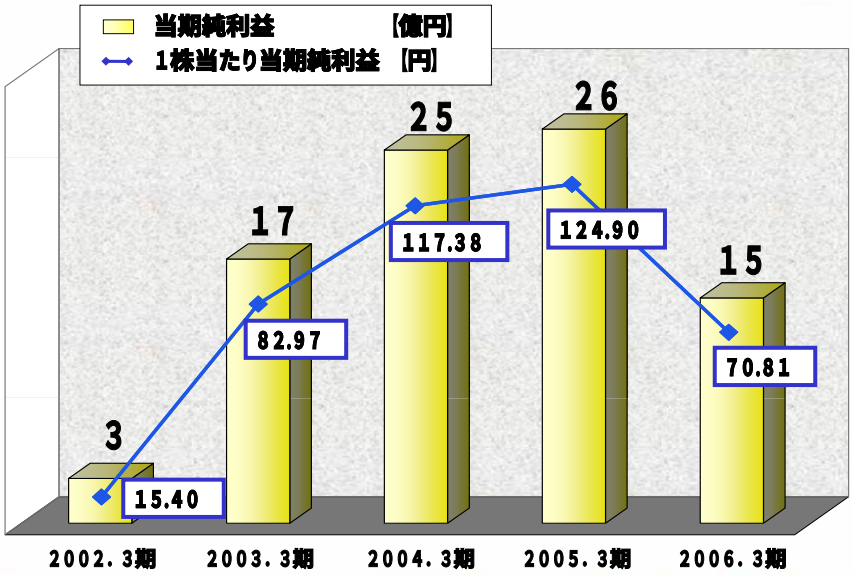
経常利益推移

（単位： 億円）

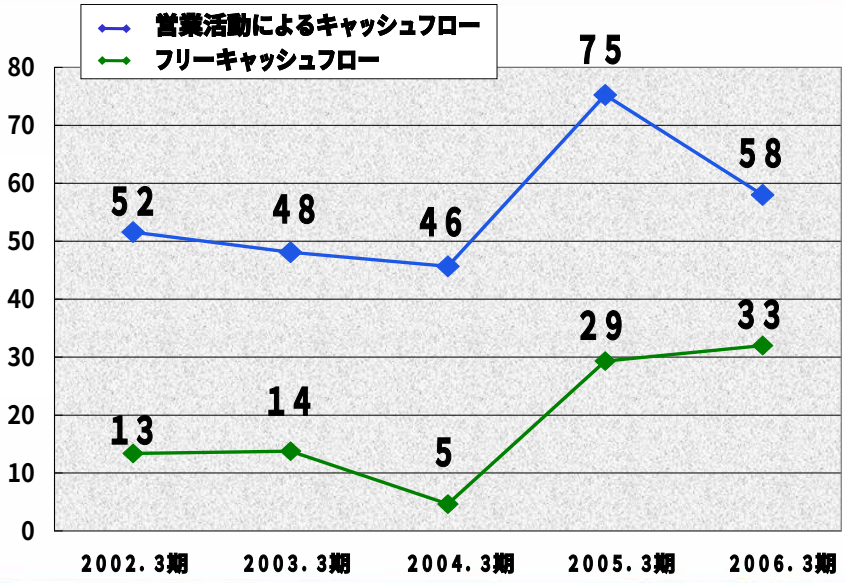


9

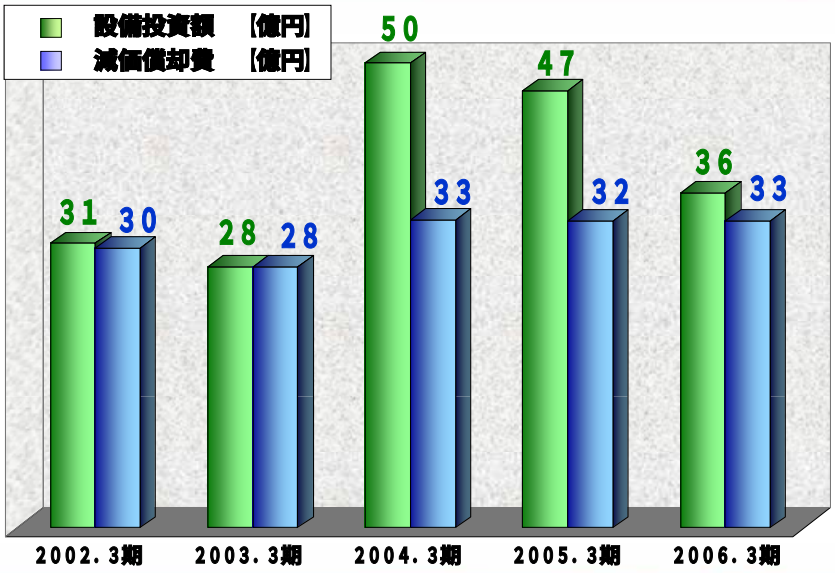
当期純利益推移



連結キャッシュフロー推移 （単位： 億円）



設備投資額と減価償却費



12

２００７年３月期
通期計画（連結）

2007年3月期 経営基本方針

創45 New Enplas の力強い発信を目指し

- 改革から成長へのゆるぎない健全経営軌道の構築
- 発明力・量産供給力を高め、業界先行力の飛躍的向上
- アジア地域を最重点としたグローバル事業の再編・最適化
- 新事業創出の加速

経営基本目標（連結）

売上高	４００億円
経常利益	３８億円

14

２００７年3月期本社（単体）新体制

■スピードと効率を重視した４本部制

◆事業本部

- ❖エンプラ事業部
- ❖オプトプラニクス事業部

２大基幹事業の拡充

安定収益力

◆本社間接部門

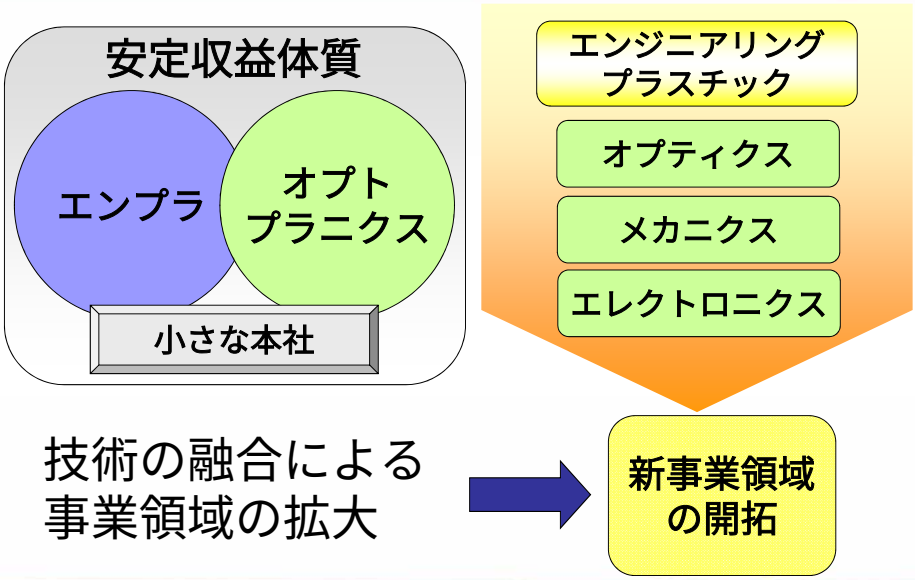
- ❖総務本部
- ❖技術管理本部
- ❖経営管理本部

“小さな本社”の実現

経営環境の急激な変化に耐えうる強靭な体制

15

２大基幹事業の充実



2007年3月期 計画

（単位： 億円）

	2006年3月期 実績		2007年3月期 計画	2007年3月期 上期計画
売上高	401.8	△0.5%	400.0	(195.0)
（原価率）	(70.8%)	(1.5ポイント)	(72.3%)	(72.6%)
営業利益	36.9	0.1%	37.0	(15.5)
経常利益	38.3	△0.9%	38.0	(16.0)
当期純利益	15.0	39.4%	21.0	(9.0)
1株当たり当期純利益	70.81円	43.2%	101.42円	(43.47円)
1株当たり配当	22.00円	△2.00円	20.00円	(10.00円)

セグメント別 売上計画

（単位： 億円）

	2006年3月期 実績		2007年3月期 計画	2007年3月期 上期計画
エンプラ事業	154.7	△3.1% →	150.0	(75.0)
半導体機器事業	58.3	16.4% →	68.0	(33.0)
液晶関連事業	90.4	△14.8% →	77.0	(37.0)
オプト事業	98.3	6.8% →	105.0	(50.0)
計	401.8	△0.5% →	400.0	(195.0)

18

参考指標

（単位： 億円）

	2006年3月期 実績	2007年3月期 計画
設備投資額	36.9	30.0
減価償却費	33.1	31.0
試験研究費	18.6	17.0
(売上高比)	(4.6%)	(4.2%)

19

各事業セグメントの
ビジネス動向

エンプラ事業の動向

2006年3月期 上期実績	2006年3月期 下期実績	2007年3月期 上期計画	2007年3月期 下期計画	
79	75	75	75	(億円)

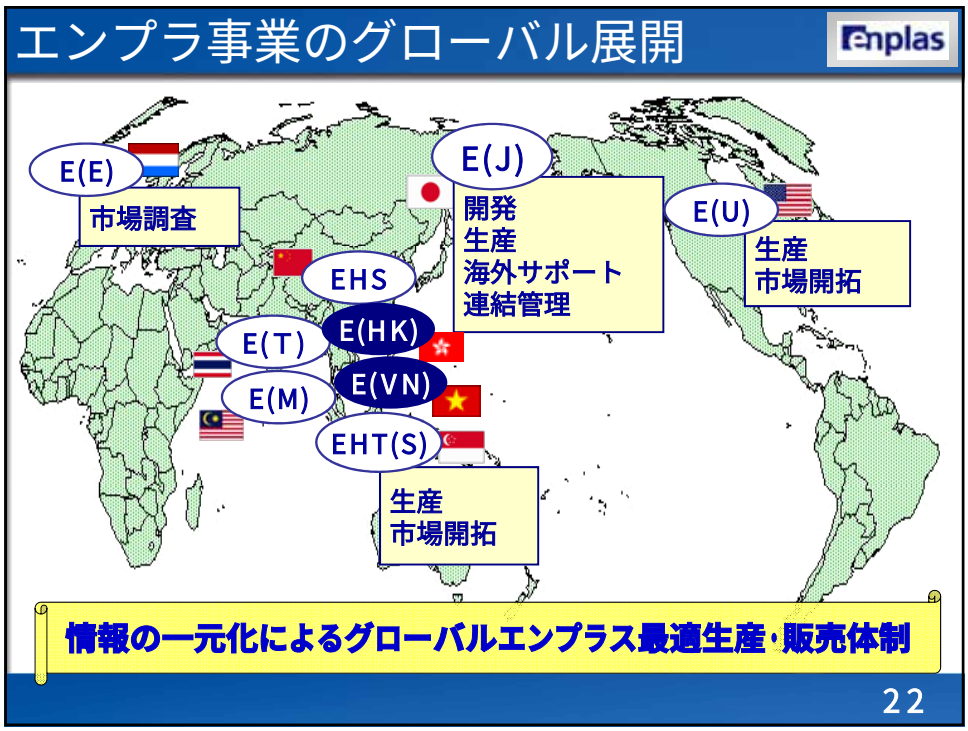
前期ハイライト

- 先進の高付加価値ギヤ生産拠点として鹿沼工場の稼動
- 新規開発品(オリジナルギヤ)によるギヤソリューションビジネスの展開
- 高付加価値事業体制の確立
  - ◆不採算製品からの撤退に目処
  - ◆金型製造システムの改革
  - ◆オリジナルギヤの開発推進

今期の戦略

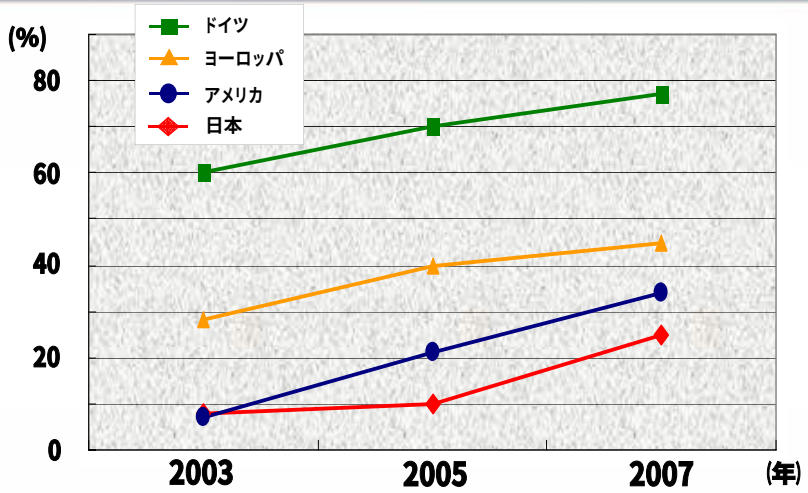
- 鹿沼工場をグローバルエンプラスのマザー工場へ
  - ◆生産技術グローバル展開
  - ◆金型製造の集約化による技術力向上と効率化
  - ◆海外拠点のサポート強化
- アジア・中国地域における新たなる市場開発の推進

21


エンプラ事業のグローバル展開
Enplas
E(E)
市場調査
E(J)
開発
生産
海外サポート
連結管理
E(U)
生産
市場開拓
EHS
E(HK)
E(T)
E(VN)
E(M)
EHT(S)
生産
市場開拓
情報の一元化によるグローバルエンプラス最適生産・販売体制
22

自動車市場の展望
Enplas
エレクトロニクス＆メカニクスの融合
運転支援システム
センサー制御ブレーキ
先進前方照明
システム(ＡＦＳ)
衝突回避システム
横滑り防止装置
（ＥＳＣ）
低燃費
安全
快適
省電力
電子制御
電動化
高効率ギヤ
高精度ギヤ
低騒音ギヤ
高機能
プラスチック
ギヤ拡大
23

横滑り防止装置（ＥＳＣ）の装着率



高い成長が期待できる分野

(当社予測)

24

半導体機器事業の動向

2006年3月期 上期実績	2006年3月期 下期実績	2007年3月期 上期計画	2007年3月期 下期計画
27	31	33	35

(億円)

前期ハイライト

- ➢東南アジア・台湾の販売体制再構築
- ➢プローブカードビジネスにおける顧客を重点化した開拓促進
- ➢顧客ニーズを先取りする最先端要素技術の応用
  - ◆高周波IC　→　放熱設計
  - ◆高電力化
  - ◆狭ピッチ化
- ➢微細ピッチ技術の確立
  - ◆メカニカル機構で0.3mm ピッチ対応

今期の戦略

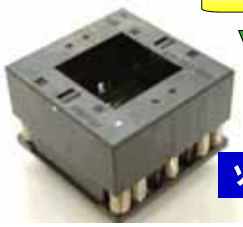
- ➢プローブカードの事業化推進
- ➢最先端要素技術を応用した ソケットの開発
- ➢鉛フリー化への対応
- ➢顧客ニーズを先取りする製品の開発と提供

25

開 発 製 品

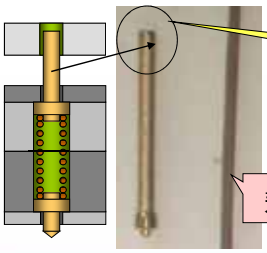
業界初の0.3mmピッチ用
バーンインソケットの開発に成功

Patent Pending



ソケット

0.3mmピッチ
ユニット



接触子先端構造に独自な技術

髪の毛

26

プローブカード ビジネス

探針付き基盤(プローブカード)

半導体製造工程の前工程
「ウエハテスト」で
ＩＣやＬＳＩに
不良がないかを調べる治具

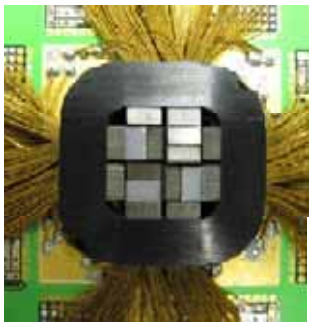
SV Probe社製プローブカードを
日本のお客様向けに設計・販売・メンテナンス

27

プローブカード ビジネス

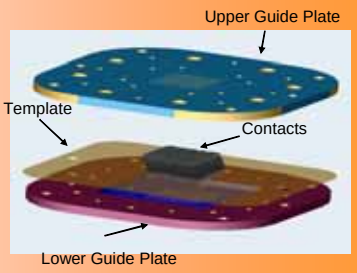
Enplas

Cantileverタイプ



・狭ピッチ対応
・マルチ測定化推進

Advancedタイプ



Advancedタイプへ
参入し業容拡大を図る

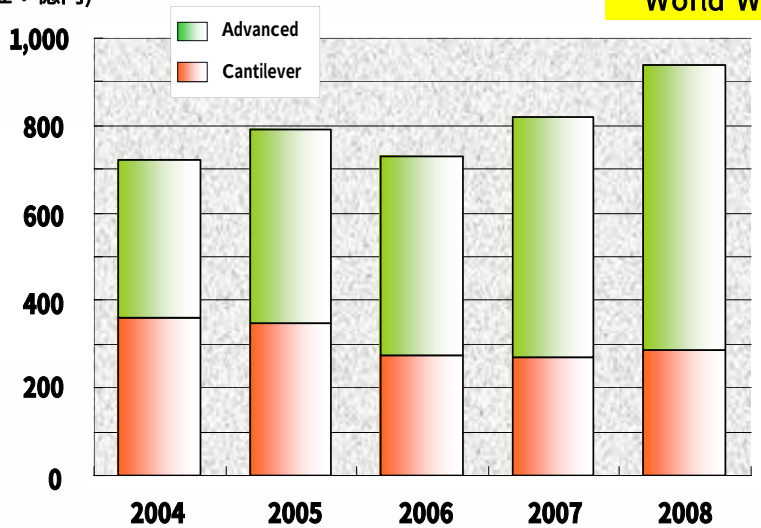
28

プローブカードの市場規模

Enplas

(単位：億円)

World Wide



(当社予測)

29

液晶事業の動向

2006年3月期 上期実績	2006年3月期 下期実績	2007年3月期 上期計画	2007年3月期 下期計画
43	46	37	40

（億円）

前期ハイライト

- ノートＰＣ用導光板のシェア拡大
  - ◆有効な特許群の存在
  - ◆生産能力向上による収益力の拡大
  - ◆新規顧客の開拓
  - ◆既存顧客のボリューム拡大
- 次世代ＬＧＰの研究

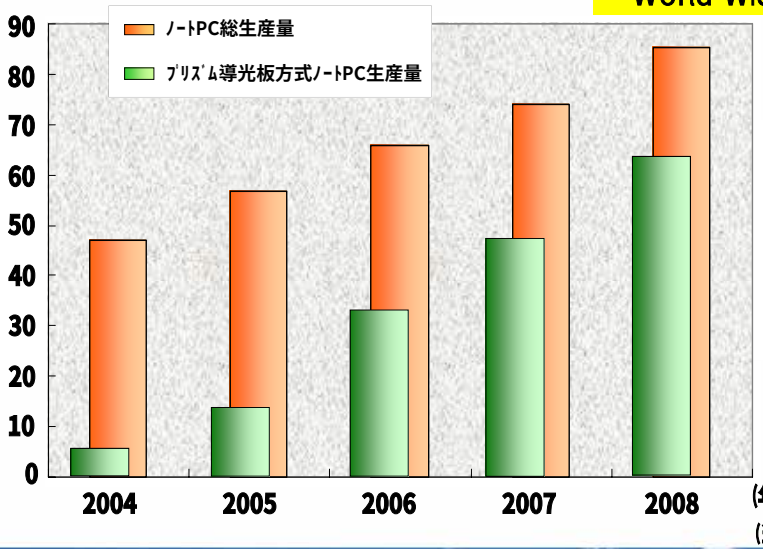
今期の戦略

- 高品位・高機能ニーズに集中した小型（携帯・デジカメ）導光板市場の開拓強化
- ノートＰＣ用高輝度バックライトのシェア拡大
- 中国・台湾市場向けサービスの強化・拡充
- 次世代ＬＧＰの開発促進

ノートPC市場動向

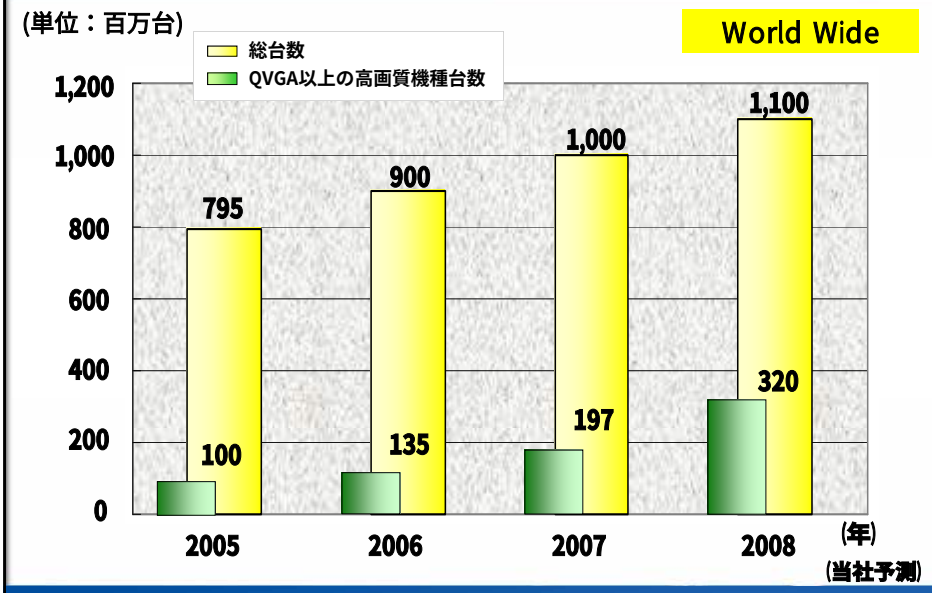
(単位：百万台)

World Wide



(当社予測)

携帯電話出荷台数予測



32

小型液晶市場をめぐる動き

小型液晶も動画を見る
複合機器に進化

ワンセグ放送の開始

カーナビ

ポータブルDVD

ハイエンド（高級品）市場は今後も成長

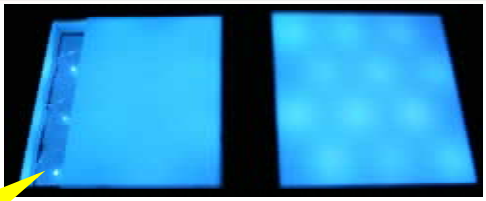
33

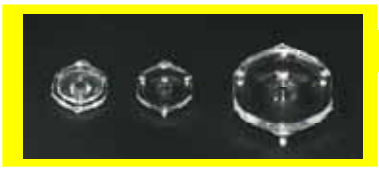
光束制御応用新分野の開拓

Enplas

ＬＥＤ光源
均一拡散レンズ

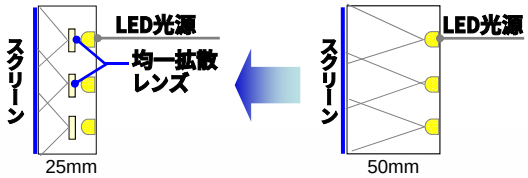
Patent Pending





光源の発光が拡散され
均一な照度

光源の発光が目立ち
照度が不均一



ユニットの大幅な薄型化
照度分布の均一化
同時に実現

オプト事業の動向

Enplas

2006年3月期 上期実績	2006年3月期 下期実績	2007年3月期 上期計画	2007年3月期 下期計画
53	45	50	55

（億円）

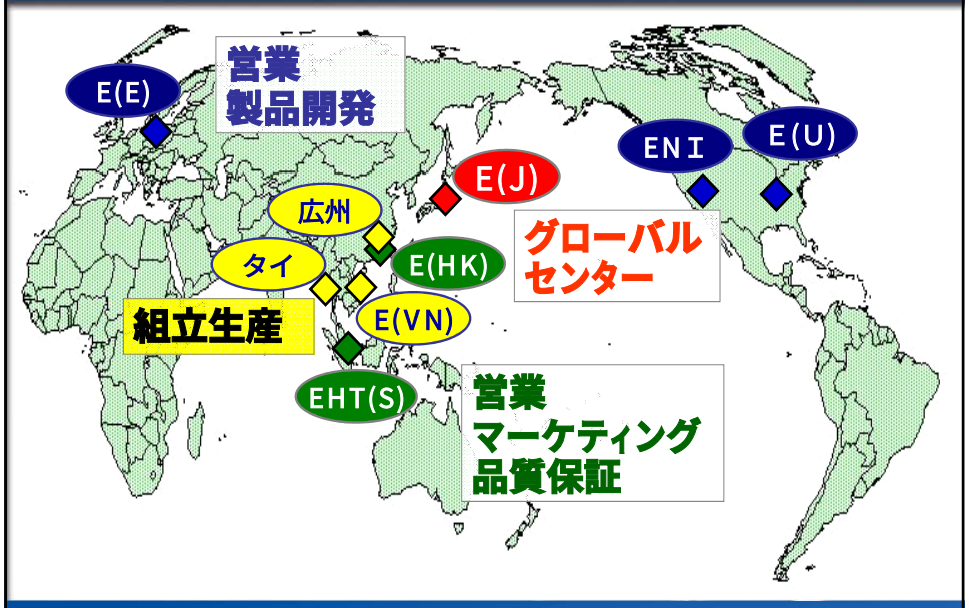
前期ハイライト

- ➢オールプラスチックによる小型・薄型化・高解像化の徹底追求
  - ◆1/8インチVGAレンズ ユニットの量産に成功
- ➢高付加価値開発製品の積極的提案
  - ◆二波長対応回折格子
  - ◆スーパーマルチ対応回折格子
- ➢新規 光インターフェース モジュール市場の開拓

今期の戦略

- ➢統合による事業領域の拡大
- ➢組立生産戦略の再構築
  - ◆E(VN)を中核拠点とする安定生産体制の構築
- ➢グローバルマーケティング力の強化

オプト事業グローバル体制



36

レンズモジュール事業の戦略

携帯電話市場

オールプラスチックレンズ
薄型化・小型化への挑戦

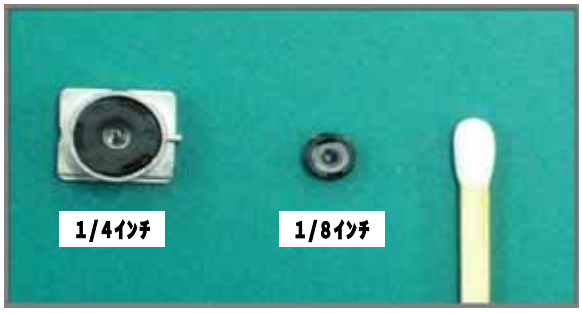
さらなる小型化

- 価格競争力
- 開発スピード短縮
- 高品質製品
- 安定生産力

さらなる高画素化

37

超小型レンズユニット

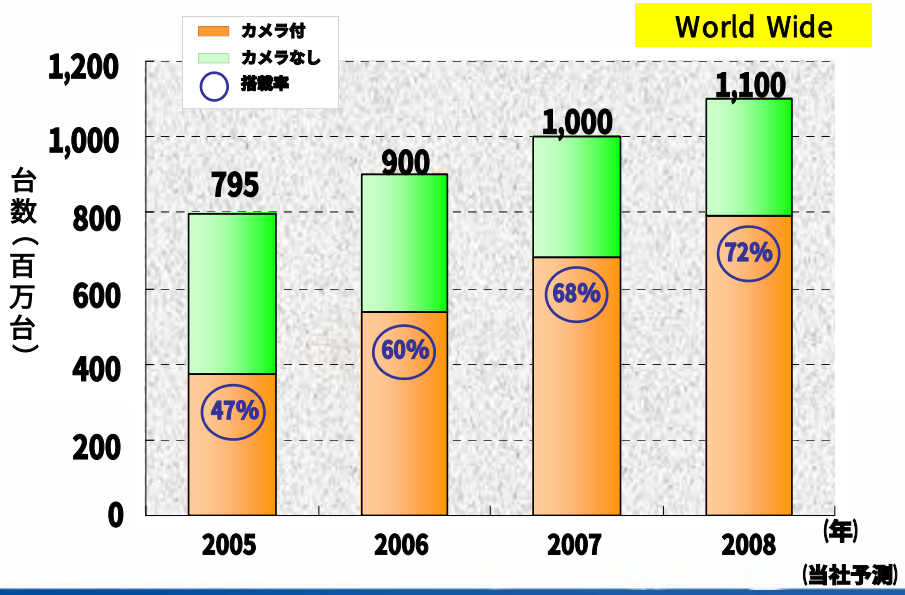


携帯電話の薄型化へのデザイン変更が主力となり、レンズユニットの**小型化**要求が急増。
ＶＧＡだけでなくＭＥＧＡにも波及の兆し。

エンプラスの強みを活かせる分野

38

携帯電話市場予測

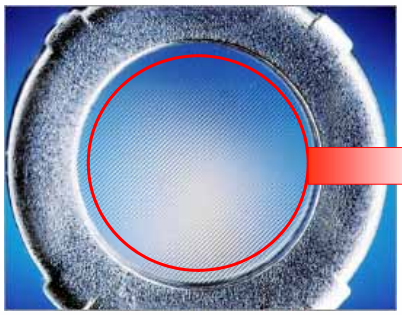


39

スーパーマルチ対応回折格子

Enplas

高付加価値複合製品への特化



特殊パターンの
回折格子構造を利用

3種類のDVD（DVD±R / DVD±RW / DVD RAM）対応

40

光インターコネクション

Enplas

超短距離・大容量・超高速

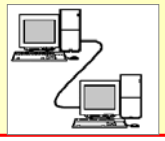
◆消費電力・電磁干渉等
問題の解消

◆入力波長数(多重通信)に応じた
飛躍的な伝送容量の増大

距離
数cm～数10m

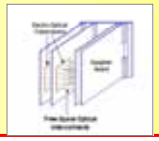
チャンネル数
100以上の多チャンネル

現在



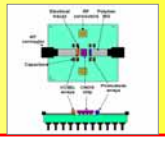
コンピュータ間の通信

２００７年頃



ボード間の配線

２０１０年代



ボード内の配線

41

Challenge 45, New Enplas

by intelligence and vitality ～英智と活力～

ご清聴ありがとうございました。

株式会社エンプラス